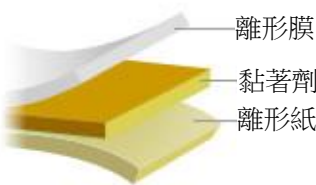


FPC D3450系列熱固膠帶

特點

- D3450系列為適於FPC補強板貼合之熱硬化膠帶。
- 吸濕後通過Reflow高溫製程亦不容易爆板。
- 可用於FR4補強板, PI補強板, AL補強板, SUS補強板, 可達到極佳的黏著強度。
- 適合儲存於室溫環境中。
- 具初期微黏性，易於定位。
- 適用於真空快壓機+熟化之製程。

結構



	D3450	D3451
主要成份	壓克力/環氧樹脂	壓克力/環氧樹脂
基材	無基材	無基材
顏色	白色	白色
黏著厚度 (μ m)	約35	約25
離形膜厚度 (μ m)	約38	約35
離形紙厚度 (μ m)	約130	約130
接著強度 (N/10mm) ※	31	25
標準尺寸 (寬度及長度)	500mm x 100M	500mm x 100M

※ 90°剝離強度 (CCL / ADH / Polyimide stiffener)

<建議壓著條件>

- 真空快壓+熟化

壓合溫度：160~180℃

壓合時間：1~2分鐘

真空時間：10~30秒

壓力：1~2 MPa

熟化條件：140℃、60分鐘
- 傳壓機

壓合溫度：160℃

壓合時間：60分鐘

壓力：3.0 MPa

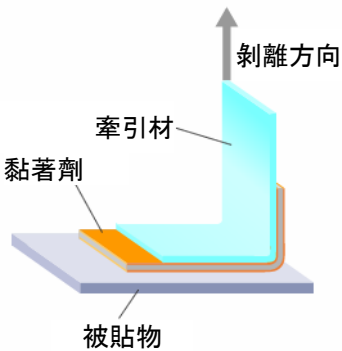
適合用途

- 適用於需經Reflow之FPC補強板(PI, FR4, AL, SUS)固定用。



1.對各被貼物之接著強度（90°剝離）

<測試件條件>
 被貼物：Glass Epoxy/Polyimide/Aluminum/Stainless stell
 膠帶寬度：10mm
 壓合條件：建議壓著條件
 量測環境：23℃±5℃, 60%±20%RH
 剝離速度：50mm/min
 牽引材：CCL（含銅箔）



< 90°剝離強度測試>

<結果>
 (N/10mm)

壓合條件	被貼物	D3450		D3451	
		一般	回焊後	一般	回焊後
真空快壓+熟化	CCL/Polyimide	31	31	25	25
	CCL/Glass Epoxy	27	28	23	23
	CCL/Aluminum	16	16	25	15
	CCL/Stainless steel	17	18	26	16
傳壓機壓合	CCL/Polyimide	26	26	21	21
	CCL/Glass Epoxy	28	28	22	22
	CCL/Aluminum	16	16	15	15
	CCL/Stainless steel	18	28	16	16



2.耐Reflow特性

<樣品製作條件>

被貼物：Polyimide film / Adhesive / CCL

壓合條件：建議壓著條件

Reflow條件：最高至260℃ (請參照迴焊曲線圖)

量測環境：23℃±5℃, 60%±20%RH

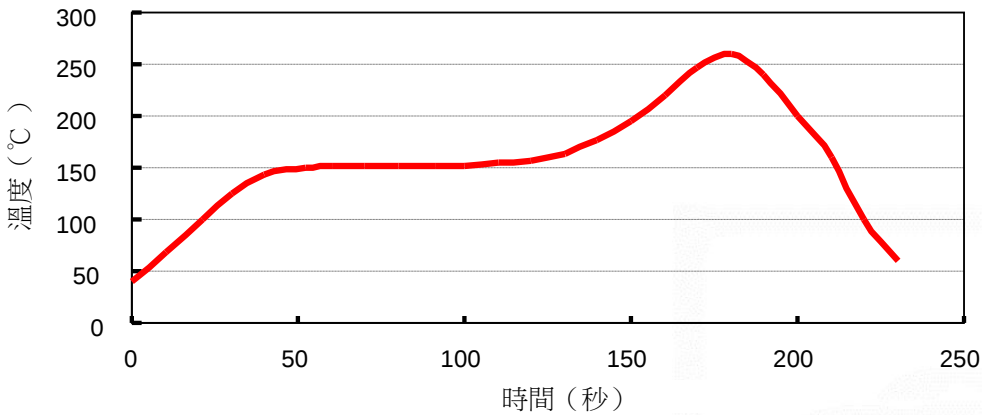
*Reflow後進行外觀確認

<結果>

壓合條件	Reflow前處理	條件	D3450	D3451
真空快壓+熟化	烘乾	1/100/-	無異狀	無異狀
	吸濕	96/40/90	無異狀	無異狀
傳壓機壓合	烘乾	1/100/-	無異狀	無異狀
	吸濕	96/40/90	無異狀	無異狀

*處理時間（H）／溫度（℃）／溼度（%）

<迴焊曲線圖>



附註

- D3450系列的溢膠量，會隨著補強板之厚度、尺寸及形狀而有所不同，使用前請先進行確認。特別是在有開孔的補強板上使用時必須特別注意。



特性資料附註：本型錄所述之產品特性資料，係根據本公司之評估結果而制訂，但不保證這些產品特性將符合使用環境之所需。因此，使用前應根據隨設備及底層所提供之評估資料而檢視相關之用途情況。

Dexerials Corporation

URL: <http://www.dexerials.jp/en/>

總公司： Gate City Osaki, East Tower 8th floor, 1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 141-0032 (日本東京)

業務及行銷部門／電話： +81-3-5435-3946

修版日期：2013年9月